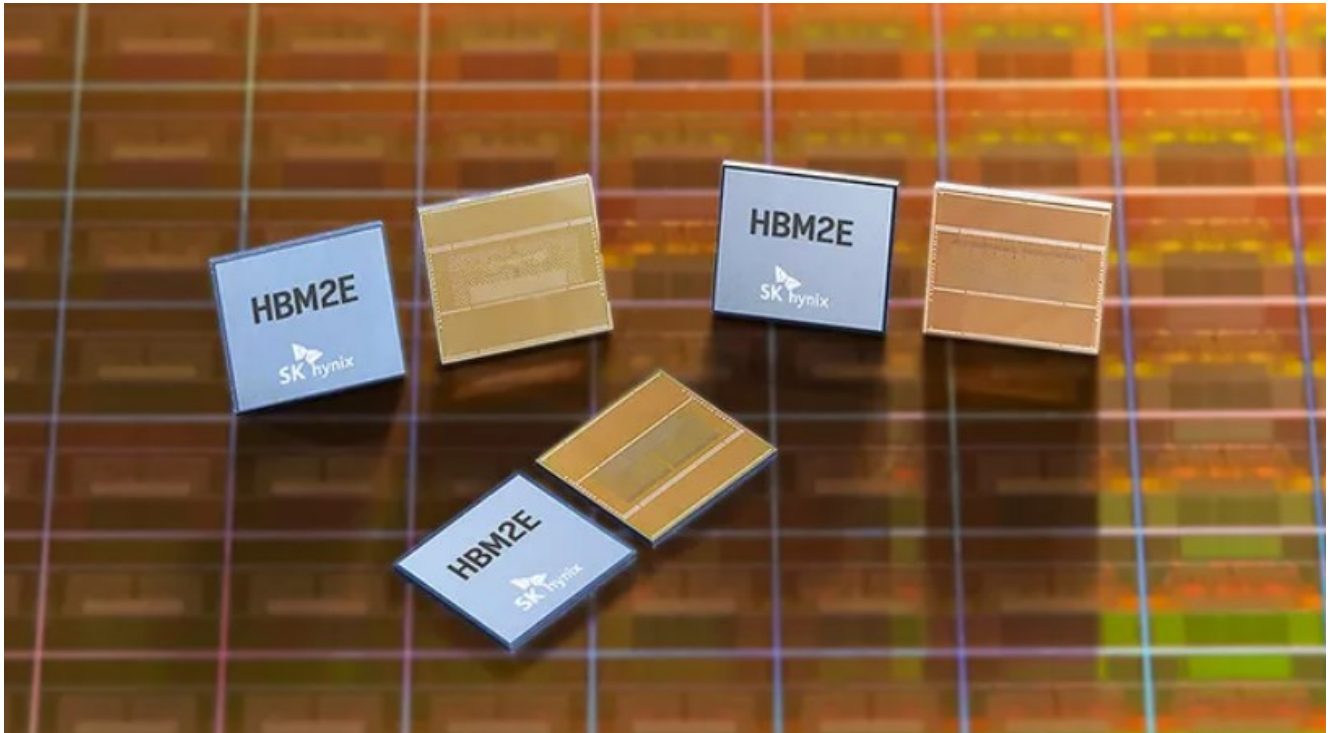


# SK Hynix tiene en desarrollo una HBM3 que alcanzará un ancho de banda de 665 GB/s por chip



SK Hynix y Samsung son los principales productores de la HBM (memoria de alto ancho de banda) y codesarrolladores junto a AMD, y no se ha llegado a imponer por el coste de producción y porque la memoria GDDR ha evolucionado hasta ofrecer anchos de banda igual de buenos.

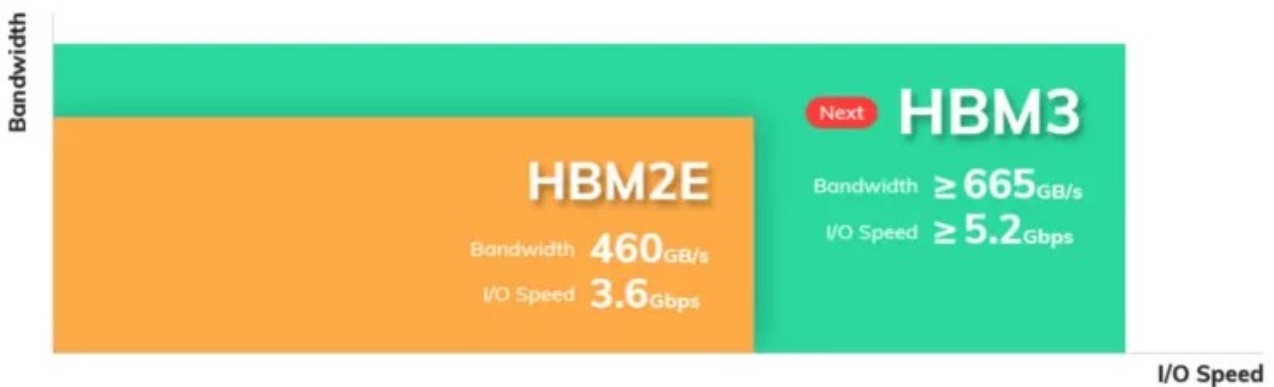
Eso sí, al menos hasta que llegue la HBM3 que está en desarrollo según lo indicado por SK Hynix, y que llegará al menos hasta los 665 GB/s de ancho de banda por chip.

Cada producto que usa HBM suele incluir dos o cuatro chips de estos, y sus anchos de banda se suman. En una disposición de cuatro chips el ancho de banda total sería de 2660 GB/s. La RTX 3090 con sus veinticuatro chips de GDDR6X tiene un ancho

de banda de 936 GB/s.

Eso sí, la HBM3 mantendrá el bus de 1024 bits, con una frecuencia de funcionamiento de 5.2 Gb/s por pin, lo cual es un salto importante desde los 3.6 Gb/s de la HBM2E actual. Lo que no se sabe es si habrá otros cambios en HBM3 que puedan diferenciarlo más de la GDDR.

Aun así, al final lo que suele primar más es el ancho de banda total por mucho que la HBM tenga ciertas ventajas de latencia en ciertos contextos, lo cual puede ser útil en cómputo pero indiferente en juegos –salvo ciertas ventajas en realidad virtual–.



Fuente: geektopia.